

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

10279100

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 3289129 A2 911219 <No. of Patents: 001>

MANUFACTURE OF THIN FILM SEMICONDUCTOR DEVICE (English)

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP

Author (Inventor): TAKENAKA SATOSHI

IPC: *H01L-021/20; H01L-021/324; H01L-021/84; H01L-029/784

CA Abstract No: 116(18)185917J

Derwent WPI Acc No: C 92-045118

JAPIO Reference No: 160120E000078

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
JP 3289129	A2	911219	JP 9090709	A	900405 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 9090709 A 900405

03626229 ****Image available****

MANUFACTURE OF THIN FILM SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 03-289129 [JP 3289129 A]

PUBLISHED: December 19, 1991 (19911219)

INVENTOR(s): TAKENAKA SATOSHI

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)
, JP (Japan)

APPL. NO.: 02-090709 [JP 9090709]

FILED: April 05, 1990 (19900405)

INTL CLASS: [5] H01L-021/20; H01L-021/324; H01L-021/84; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1182, Vol. 16, No. 120, Pg. 78, March
26, 1992 (19920326)

ABSTRACT

PURPOSE: To get a crystalline solid growth Si film excellent in crystal grain diameter by the annealing for only several hours by growing an amorphous semiconductor thin film on an insulating substrate, and continuously heat- treating the amorphous semiconductor thin film without taking it out in the air so as to subject it to solid growth.

CONSTITUTION: An a-Si film 1-2 is stacked on an amorphous insulating substrate 1-1. To stack the a-Si:H film, the substrate 1-1 shall be placed in a chamber 2-1, and silane gas (SiH_4) shall be diluted into proper concentration with helium gas (He) or hydrogen gas (H_2), and decomposed and stacked by applying high frequency voltage. When the growth of the a-Si:H film is finished, the reaction gas such as silane used for film growth is exhausted, and the inside of the chamber is vacuumized, and the substrate holder 2-3 inside the chamber is heated gradually, and the a-Si:H film 1-2 is subjected to solid growth to form a solid growth Si film 1-3. The heating temperature at this time shall be 600 deg.C or 700 deg.C at upper limit.

⑬ Int. Cl.⁵

H 01 L 21/20
21/324
21/84
29/784

識別記号

庁内整理番号

7739-4M

7739-4M

⑭ 公開 平成3年(1991)12月19日

9056-4M H 01 L 29/78 311 F
審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

⑮ 発明の名称 薄膜半導体装置の製造方法

⑯ 特 願 平2-90709

⑰ 出 願 平2(1990)4月5日

⑱ 発 明 者 竹 中 敏 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式
会社内

⑲ 出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
会社

⑳ 代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

薄膜半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 絶縁基板上に非晶質半導体薄膜を成膜し、該非晶質半導体薄膜を大気中に取り出すことなく連続して熱処理することにより固相成長させる工程を少なくとも含むことを特徴とする薄膜半導体装置の製造方法。

(2) 特許請求の範囲第1項記載の薄膜半導体装置の製造方法において、プラズマCVD装置のチェンバー内に絶縁基板を設置しモノシラン(SiH_4)あるいはジシラン(Si_2H_6)あるいはトリシラン(Si_3H_8)を少なくとも含む混合ガスを導入し、グロー放電分解により $\alpha\text{-Si:H}$ (水素化非晶質シリコン)膜を堆積する工程と、その後前記混合ガスを排気した後前記チェンバー内を大気圧に戻すことなく真空のまま、もしくは窒素ガスあるいはヘリウムガスあるいはアルゴンガス等の不活性ガスに置換し、600℃～700℃

に徐々に昇温して前記 $\alpha\text{-Si:H}$ 膜を固相成長させて固相成長Si膜を形成させる工程を少なくとも含むことを特徴とする薄膜半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、薄膜半導体装置の製造方法に関わり、特に、大粒径Si膜の形成方法に関する。

[従来の技術]

非晶質絶縁基板あるいは非晶質絶縁膜上に、結晶方位の揃った結晶粒径の大きな多結晶シリコン薄膜、あるいは単結晶シリコン薄膜を形成する方法は、SOI(Silicon On Insulator)技術として知られている。(参考文献 SOI構造形成技術、産業図書)。大きく分類すると、再結晶化法、エピタキシャル法、絶縁層埋め込み法、貼り合わせ法という方法がある。再結晶化法は、レーザーアニールあるいは電子ビームアニールによりシリコンを熔融再結晶化させる方法と、熔融する温度までは昇温させずに固相

成長させる固相成長法の2つに分類される。比較的低温で再結晶化できるという点で固相成長法が優れている。550℃の低温熱処理にもかかわらずシリコン薄膜の結晶粒が成長したという結果も報告されている。(参考文献 IEEE Electron Device Letters, vol. EDL-8, No. 8, p361, August 1987)。さらに近年、SOIあるいは、三次元ICや、大型液晶表示パネルや、高速で高解像度の密着型イメージセンサ等へのニーズが高まるにつれて、低温で良質のゲート絶縁膜を形成する技術が重要となってきた。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の固相成長法では、非晶質シリコン膜を堆積させた後、一旦大気中に取り出してから固相成長工程にはいていた。従って非晶質シリコン膜表面には結晶成長の妨げとなる酸素やその他の不純物が吸着しており充分な結晶成長が得られなかった。

本発明は、このような問題点を解決し、結晶粒径

ス等の不活性ガスに置換し、600℃～700℃に徐々に昇温して前記a-Si:H膜を固相成長させて固相成長Si膜を形成させる工程を少なくとも含むことを特徴とする。

【実施例】

第1図(a)に於て、1-1は非晶質絶縁基板である。石英基板あるいはガラス基板などが用いられる。SiO₂で覆われたSi基板を用いることもある。石英基板あるいはSiO₂で覆われたSi基板を用いる場合は1200℃の高温プロセスにも耐えることができるが、ガラス基板を用いる場合は軟化温度が低いために約800℃以下の低温プロセスに制限される。また、ガラス基板は、酸化膜あるいは窒化膜でコーティングして基板からの不純物のしみだしを防止して用いられることもある。はじめに非晶質絶縁基板1-1上にa-Si膜1-2を堆積させる。該a-Si膜1-2は一般で、微細な結晶子は含まれておらず結晶成長の核が全く存在しないことが望ましい。堆積方法としてはEB(Electron Beam)蒸

の大きなシリコン膜を簡単な固相成長法によって形成して非常に優れた特性を有するTFTを実現することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

本発明の薄膜半導体装置の製造方法は、(1)

絶縁基板上に非晶質半導体薄膜を成膜し、該非晶質半導体薄膜を大気中に取り出すことなく連続して熱処理することにより固相成長させる工程を少なくとも含むことを特徴とする薄膜半導体装置の製造方法。

(2) 特許請求の範囲第1項記載の薄膜半導体装置の製造方法において、プラズマCVD装置のチェンバー内に絶縁基板を設置しモノシラン(SiH₄)あるいはジシラン(Si₂H₆)あるいはトリシラン(Si₃H₈)を少なくとも含む混合ガスを導入し、グロー放電分解によりa-Si:H(水素化非晶質シリコン)膜を堆積する工程と、その後前記混合ガスを排気した後、前記チェンバー内を大気圧に戻すことなく真空のまま、もしくは窒素ガスあるいはヘリウムガスあるいはアルゴンガ

ス法やスパッタ法やCVD法や光CVD法やプラズマCVD法がある。プラズマCVD法は、光起電力素子や、フォトダイオードや、感光ドラムなどを作製する場合によく用いられる方法である。a-Si:H膜を堆積させるには、シランガス(SiH₄)をヘリウムガス(H₂)あるいは水素ガス(H₂)で適した濃度に希釈し、高周波電圧を印加して、分解堆積させる。プラズマCVD法の場合は、基板温度が500℃以下でも成膜できる。前記シランガスの代わりにジシランガスあるいはトリシランガスを用いると、さらに低い基板温度でも成膜することが可能となる。また、デポ直前に水素プラズマあるいはアルゴンプラズマ処理を行えば、基板表面の清浄化と成膜を連続的に行うことができる。第2図にプラズマCVD装置のチェンバーの断面模式図を示す。2-1はチェンバー、2-2は高周波電源、2-3は基板ホルダー、2-4は基板を示している。

a-Si:H膜の成膜が終わったら、成膜にもちいたシランなどの反応ガスを排気し、チェンバ

内を真空に引く。このときの到達真空度は少なくとも 1×10^{-6} Torr以下であることが望ましい。

つづいて、チェンバー内の基板ホルダー2-3を徐々に加熱して、前記a-Si:H膜1-2を固相成長させる。このときの加熱温度は600℃または700℃を上限とする。この様な低温アニールでは選択的に、結晶成長の活性化エネルギーの小さな結晶方位を持つ結晶粒のみが成長し、しかもゆっくりと大きく成長する。第1図(b)において1-3は固相成長Si膜を示している。また第2図の2-1で示した前記チェンバー内は窒素ガスやヘリウムガスやアルゴンガス等の不活性ガス雰囲気でもよい。a-Si:H膜からの水素放出が急激にならないように昇温速度 $v_{\text{昇}}$ はなるべく小さくするのが望ましい。固相成長終了後、降温速度 $v_{\text{降}}$ は $v_{\text{昇}}$ よりも小さいほうがよい。第3図(a)に固相成長アニール昇温カーブを示す。縦軸はアニール温度、横軸は時間を示している。水素の放出を徐々にこなうために450℃程

ロー放電分解させるプラズマCVD法で堆積させて作成してもよい。酸化膜1-4形成後、約500℃以下のアニールにより前記酸化膜1-4を緻密化させてもよい。

続いて第1図(e)に示されるように、ゲート電極1-5を形成する。該ゲート電極材料としては多結晶シリコン薄膜、あるいはモリブデンシリサイド、あるいはアルミニウムやクロムなどのような金属膜、あるいはITOやSnO₂などのような透明性導電膜などを用いることができる。成膜方法としては、プラズマCVD法、CVD法、スパッタ法、真空蒸着法、等の方法がある。プラズマCVD法によりリン、あるいはボロンをドーブしたa-Si:H膜を堆積して固相成長させたSi膜をゲート電極として用いるとゲート配線抵抗を低減することが出来る。

続いて第1図(f)に示すように、前記ゲート電極1-5をマスクとして不純物をイオン注入し、自己整合的にソース領域1-6およびドレイン領域1-7を形成する。前記不純物としては、Nc

度の温度でしばらくの時間保持してアニールしてもよい。その昇温カーブを第3図(b)に示す。

次に前記固相成長した固相成長Si膜1-3をフォトリソグラフィ法によりパターンニングして第1図(c)に示すように島状にする。

次に第1図(d)に示されているように、ゲート酸化膜1-4を形成する。該ゲート酸化膜の形成方法としてはLPCVD法、あるいは光励起CVD法、あるいはプラズマCVD法、ECRプラズマCVD法、あるいは高真空蒸着法、あるいはプラズマ酸化法、あるいは高圧酸化法などのような500℃以下の低温方法がある。該低温方法で成膜されたゲート酸化膜は、熱処理することによってより緻密で界面準位の少ない優れた膜となる。非晶質絶縁基板1-1として石英基板を用いる場合は、熱酸化法によることができる。該熱酸化法にはdry酸化法とwet酸化法とがあるが、酸化温度は1000℃以上と高いが膜質が優れていることからdry酸化法の方が適している。酸化膜1-4はN₂Oガスとシランガスの混合ガスを

hトランジスタを作製する場合はP⁺あるいはAs⁺を用い、Pchトランジスタを作製する場合はB⁺等を用いる。不純物添加方法としては、イオン注入法の他に、レーザードーピング法あるいはプラズマドーピング法などの方法がある。1-8で示される矢印は不純物のイオンビームを表している。前記非晶質絶縁基板1-1として石英基板を用いた場合には熱拡散法を使うことができる。不純物濃度は、 1×10^{15} から 1×10^{20} cm⁻³程度とする。

続いて第1図(g)に示されるように、層間絶縁膜1-9を積層する。該層間絶縁膜材料としては、酸化膜あるいは窒化膜などを用いる。絶縁性が良好ならば膜厚はいくらでもよいが、数千Åから数μm程度が普通である。窒化膜の形成方法としては、LPCVD法あるいはプラズマCVD法などが簡単である。反応には、アンモニアガス(NH₃)とシランガスと窒素ガスとの混合ガス、あるいはシランガスと窒素ガスとの混合ガスなどを用いる。

ここで、水素プラズマ法、あるいは水素イオン注入法、あるいはプラズマ酸化膜からの水素の拡散法などの方法で水素イオンを導入すると、ゲート酸化膜界面などに存在するダングリングボンドなどの欠陥が不活性化される。この様な水素化工程は、層間絶縁膜1-9を積層する前におこなってもよい。

次に第1図(h)に示すように、前記層間絶縁膜及びゲート絶縁膜にコンタクトホールを形成し、コンタクト電極を形成しソース電極1-10およびドレイン電極1-11とする。該ソース電極及びドレイン電極は、アルミニウムなどの金属材料で形成する。この様にして薄膜トランジスタが形成される。

【発明の効果】

従来の固相成長法では、例えばa-Si膜を堆積した後固相成長アニールするためにチェンバーから大気に取り出してからアニール炉に再び設置していた。このように前記a-Si膜は大気にさらされてから固相成長するという工程であった。

もちいることができる。優れたシリコン薄膜が得られるのにかかわらずコストアップとはならない。

本発明によって得られたゲート絶縁膜と大粒径多結晶シリコン薄膜を用いて薄膜トランジスタを作成すると、優れた特性が得られる。従来に比べて、薄膜トランジスタのON電流は増大しOFF電流は小さくなる。またスレッショルド電圧も小さくなりトランジスタ特性が大きく改善される。NチャネルとPチャネルとの特性の不釣り合いさも改善される。

非晶質絶縁基板上に優れた特性の薄膜トランジスタを作製することが可能となるので、ドライバ回路を同一基板上に集積したアクティブマトリクス基板に応用した場合にも十分な高速動作が実現される。さらに、電源電圧の低減、消費電流の低減、信頼性の向上に対して大きな効果がある。また、600℃以下の低温プロセスによる作製も可能なので、アクティブマトリクス基板の低価格化及び大面積化に対してもその効果は大きい。

本発明を、光電変換素子とその走査回路を同一

従ってa-Si膜表面は酸素をはじめ結晶成長を妨げるような不純物によって汚染されており、Si膜の結晶粒径を大きくさせたり結晶性を改善させるために数十から数百時間という長いアニール時間が必要であった。

本発明によれば、a-Si:H膜の成膜と固相成長を同一チェンバー内で連続して処理することが出来る。従ってa-Si:H膜の表面が清浄な状態で固相成長ができるので固相成長に要する時間が短縮され、わずか数時間のアニールで結晶粒径の大きな優れた結晶性の固相成長Si膜が得られる。

本発明により、非常に優れた固相成長TFTを実現することが可能となる。

数十～数百℃の基板温度で堆積可能なので、軟化温度の低いガラス基板を用いることもできる。

SOI技術の発展に大きく寄与するものである。フォトリソグラフィ工程数はまったく増えない。600℃以下の低温のプロセスでも作製が可能なので、価格が安くて耐熱温度が低いガラス基板を

チップ内に集積した密着型イメージセンサーに応用した場合には、読み取り速度の高速化、高解像度化、さらに階調をとる場合に非常に大きな効果をうみだす。高解像度化が達成されるとカラー読み取り用密着型イメージセンサーへの応用も容易となる。もちろん電源電圧の低減、消費電流の低減、信頼性の向上に対してもその効果は大きい。また低温プロセスによって作製することができるので、密着型イメージセンサーチップの長尺化が可能となり、一本のチップでA4サイズあるいはA3サイズの様な大型ファクシミリ用の読み取り装置を実現できる。従って、センサーチップの二本並ぎのような手取がかかり信頼性の悪い技術を回避することができ、実装歩留りも向上される。

この他、高結晶液晶テレビあるいは駆動回路を同一基板上に集積したサーマルヘッドへの応用も可能となる。

石英基板やガラス基板だけでなく、サファイア基板(Al_2O_3)あるいは $MgO \cdot Al_2O_3$ 、BP、CaF₂等の結晶性絶縁基板も用いることが

できる。

以上実施例では薄膜トランジスタを例として説明したが、通常のMOSトランジスタやバイポーラトランジスタあるいはヘテロ接合バイポーラトランジスタなど薄膜を利用した素子に対しても、本発明を応用することができる。また、三次元デバイスのようなSOI技術を利用した素子に対しても、本発明を応用することができる。

なお実施例では、非晶質半導体薄膜の形成方法としてプラズマCVD装置を用いた場合について説明したが、EB蒸着法やスパッタ法や減圧CVD法等他の方法を用いることもできる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)から(h)は、本発明の実施例を示す工程断面図である。

第2図は、プラズマCVD装置のチェンバー断面図である。

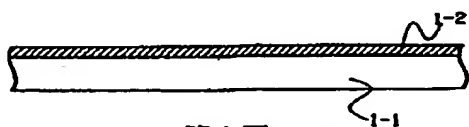
第3図(a)と(b)は、固相成長のアニール条件示す昇温カーブである。

- 1-2 ; a-Si:H膜
1-3 ; 固相成長Si膜
1-4 ; ゲート酸化膜

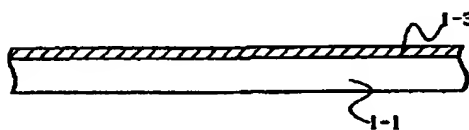
以上

出願人 セイコーエプソン株式会社

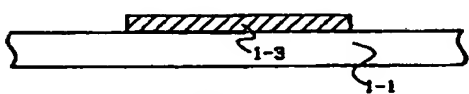
代理人 弁理士 鈴木喜三郎他1名



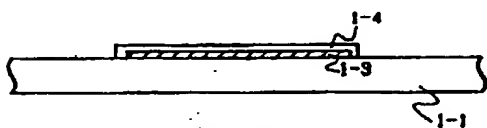
第1図 (a)



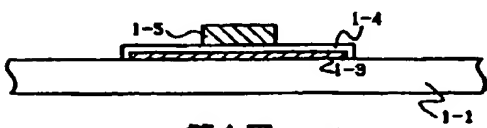
第1図 (b)



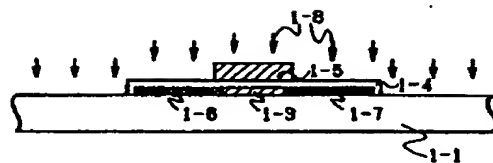
第1図 (c)



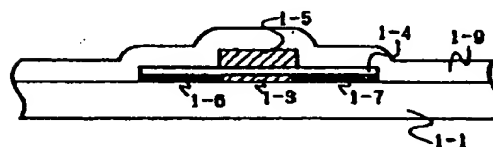
第1図 (d)



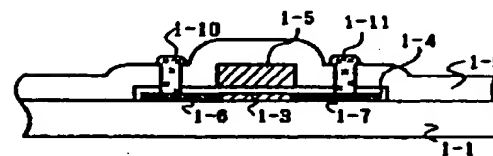
第1図 (e)



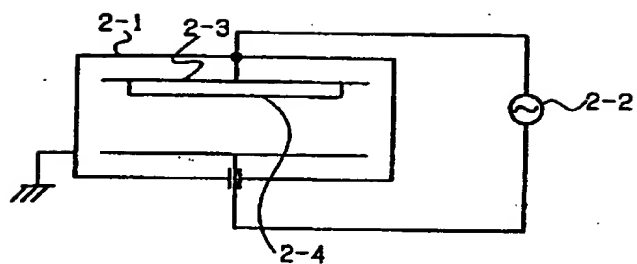
第1図 (f)



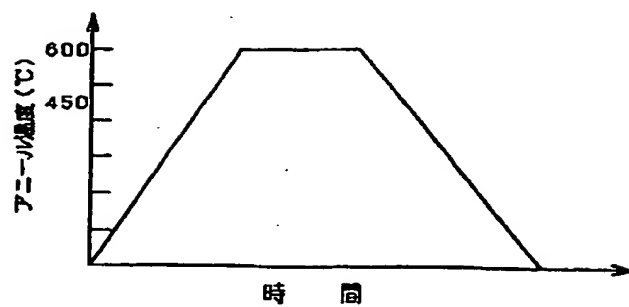
第1図 (g)



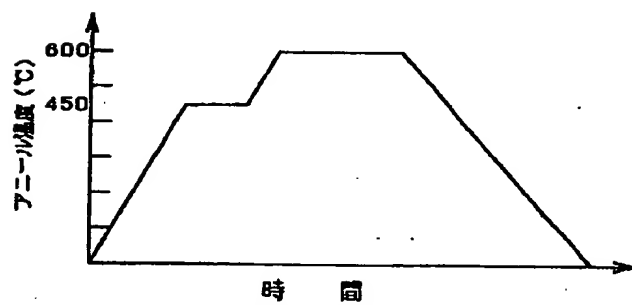
第1図 (h)



第2図



第3図 (a)



第3図 (b)